

人事異動および機構改革のお知らせ

【概 要】

<会社名>

株式会社村田製作所

<発令日>

2023 年 11 月 1 日

<人事異動>

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
法務・知財統括部 法務部 部長	法務・知財統括部 法務部 担当部長		田原 智史 (たはら さとし)
通信・センサ事業本部 高周波デバイス事業部 商品技術部 部長	通信・センサ事業本部 高周波デバイス事業部 多層商品技術部 部長 兼 SAW 商品技術部 部長		丹南 裕一 (たんなん ゆういち)
通信・センサ事業本部 通信モジュール事業部 コネクティビティモジュール企画販 推部 部長		通信・センサ事業本部 通信モジュール事業部 事業部長	橋本 征朋 (はしもと まさとも)

【概 要】

<機構改革>

1. 高周波デバイス事業部の組織改定

- 商品技術機能である多層商品技術部および SAW 商品技術部を統合し、商品技術部として再編する。

以上